プリント基板加工装置

レーザーやドリルで、セラミック基板、ガラスエポキシ基板上に配線加工や穴あけ加工を行い、プリント基板を試作する装置

[型式]

レーザー基板加工機　ProtoLaser S(LPKF 社製)

ミリング基板加工機　ProtoMat43A(LPKF 社製)

電子回路 CAD　Opser(ユニクラフト社製)

[仕様]

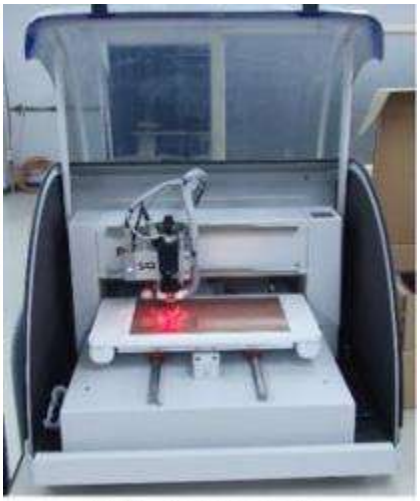
レーザー基板加工機　最大基板寸法：305×229×10㎜　最小ライン幅：50μm

ミリング基板加工機　最大基板寸法：305×229×14㎜　最小ライン幅：100μm

[設置年度]

2013 年度（平成 25 年度）

レーザー基板加工機



ミリング基板加工機

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日